

Unimicron Germany investiert in neues Gebäude und modernste Leiterplattenfertigungstechnologie

August 2022

Seite 1 von 4

Geldern, im August 2022

Unimicron Germany mit Sitz in Geldern (Nordrhein-Westfalen) hat erneut in einen Neubau und in modernste Fertigungstechnologie zur Herstellung hochtechnologischer Leiterplatten investiert. Das neue Gebäude liegt direkt neben der im Jahr 2018 errichteten Innenlagenfertigung, die zu den modernsten in Europa zählt. Unimicron Germany baut damit seine Technologieführerschaft im Bereich Leiterplattentechnologie weiter aus und zeigt einmal mehr Verantwortung in puncto Nachhaltigkeit. Zudem stärkt der Unimicron Mutterkonzern mit seinen Investitionen den Standort Deutschland. Die Investition von ~12 Mio. EUR umfasst das neue Gebäude, Infrastruktur und Equipment für die Fertigungsprozesse Desmear, chemische und galvanische Verkupferung, sowie eine Grundwassersanierungsanlage und modernste Brandschutztechnologie.

Pressekontakt:

Beate Weigandt

Email: beate.weigandt@unimicron.de

Oliver Holz

Email: oliver.holz@unimicron.de

Telefon: 0 28 31 - 3 94 - 0

Unimicron Germany kommt mit dem Neubau und der Installation von Prozesstechnologie, die auf dem aktuellen Stand der Technik ist, den steigenden Markt- und Kundenanforderungen aus Automotive, Erneuerbare Energien, Industrie und Medizintechnik nach. Der Einsatz von Robotik erhöht den bereits hohen Automatisierungsgrad der Fertigung und gewährleistet zudem ein besseres und schonendes Handling von Leiterplatten. Mit der Investition in fortschrittlichste Prozesse und Gebäude stellt sich Unimicron Germany den Herausforderungen der Zukunft im Hinblick auf Flexibilität, Technologie und Kapazität, sowie auf Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung.

Höchste Flexibilität und beste Ergebnisse

Mit der neuen vertikalen Plating-Anlage (VCP) kann ein breites Spektrum verschiedener Leiterplattentypen hergestellt werden. Durch den berührungslosen Transport von PCBs in 0,4 mm bis einschließlich 3,2 mm Dicke ist Unimicron Germany somit gerüstet, die immer weiter steigenden Kundenanforderungen im Bereich Plattieren auch in Zukunft zu realisieren. Die Kupferbeschichtungsanlage ermöglicht es, verschiedenste Materialien für hochlagige Multilayer, aber auch HDI-PCBs und IC-Substrate zu verwenden. Die neue Linie, mit einer Länge von 48 Metern, ist mit einer vollautomatischen Be- und Entladeeinrichtung sowie einer RFID-Erkennung zur internen Rückverfolgbarkeit ausgestattet. Sie bietet ein Höchstmaß an Flexibilität in Bezug auf Produktionskapazität, Kupferschichtdicken, Leiterplattentechnologien und -abmessungen.

Unimicron Germany GmbH

Am Holländer See 70 · 47608 Geldern

Phone: +49 2831 394-0 · info@unimicron.de · www.unimicron.de

Die neue horizontale Durchkontaktierungslinie trägt neben einer vergrößerten technologischen Flexibilität auch zu einer signifikanten Einsparung von Wasser und Energie bei und erhöht gleichzeitig die Lebensdauer der eingesetzten Chemikalien.

Auf einer gesamten Anlagenlänge von 58 Metern laufen die Prozessschritte Desmear, chemisch Kupfer und die galvanische Cu-Vorverstärkung unter optimalen Bedingungen. Das Verfahren wird für Durchgangsbohrungen und mechanische Sacklöcher in Standardtechnik, sowie für Laserbohrungen (Microvias) bei HDI- und SPU-Technik mit hohen Anforderungen hinsichtlich dem Aspect Ratio eingesetzt.

In der Durchkontaktierungslinie kann ein sehr breites Spektrum an Basismaterialien, wie z.B. gefüllte und Hoch-Tg-Materialien, RCC-Folien, multifunktionale Epoxidharz Glasgewebe, thermisch optimierte Materialien und PTFE Lamine bearbeitet werden. Gerade bei letzterem wirken sich die vollautomatische Be- und Entladeeinheiten sehr vorteilhaft hinsichtlich des Vermeidens von mechanischen Beschädigungen aus.

August 2022

Seite 2 von 4

Pressekontakt:

Beate Weigandt

Email: beate.weigandt@unimicron.de

Oliver Holz

Email: oliver.holz@unimicron.de

Telefon: 0 28 31 - 3 94 - 0

Nachhaltige und effiziente Grundwasseraufbereitung

Die Umweltauflagen in Deutschland wurden in den letzten Jahren stetig verbessert, auch im Hinblick auf die Klimakrise und den damit verbundenen Auswirkungen.

Unimicron Germany hat sich dieser Herausforderungen gestellt, d. h. eine nach dem neuesten Stand der Technik automatisierte Grundwassersanierungsanlage zu bauen und in Betrieb zu nehmen.

Früher wurden bei verschiedenen Fertigungsschritten der Leiterplattenherstellung unterschiedliche Lösungsmittel eingesetzt bzw. verwendet. Durch die in der Vergangenheit deutlich schlechteren technischen Möglichkeiten und weniger hohen Umweltnormen bzw. -auflagen konnte nicht verhindert werden, dass Anteile dieser Lösungsmittel ins Erdreich und damit später ins Grundwasser gelangten.

Um diese „Altlasten“ aus dem Grundwasser zu entfernen, hat Unimicron Germany (früher RUWEL) bereits 1992 damit begonnen, die Verunreinigungen im Grundwasser zu entfernen.

Die bis dato in unserem Haus eingesetzte Grundwassersanierungsanlage entsprach nicht mehr den aktuellen umwelttechnischen Anforderungen sowie dem jetzigen Stand der Technik.

Aus diesem Grund hat sich Unimicron Germany, in Abstimmung mit der Bezirksregierung in Düsseldorf, dazu entschlossen, eine neue Grundwasser-sanierungsanlage zu bauen, welche im Januar 2022 in Betrieb genommen wurde.

Mit dieser neuen Anlage, die außerdem ressourcenschonend (z. B. sparsamer Umgang mit Wasser usw.) arbeitet, ist Unimicron Germany davon überzeugt, langfristig die Forderungen der Bezirksregierung in Düsseldorf zu erfüllen und damit einen aktiven Beitrag zum Schutz unserer Umwelt zu leisten.

August 2022

Seite 3 von 4

Pressekontakt:

Beate Weigandt

Email: beate.weigandt@unimicron.de

Oliver Holz

Email: oliver.holz@unimicron.de

Telefon: 0 28 31 - 3 94 - 0

Über Unimicron Germany

Unimicron Germany (ehemals Ruwel) ist traditionsreichster und einer der führenden Hersteller von Leiterplatten in Deutschland. Das hoch automatisierte Innenlagenwerk ist das modernste in Europa. Das breite Produktspektrum reicht von Leiterplatten in Standardtechnologie wie doppelseitige Leiterplatten und Multilayer bis 30 Lagen bis hin zu anspruchsvolleren Technologien wie HDI, Dickkupfer-Techniken, Hochfrequenz-PCBs oder Semiflex. Egal ob Muster, kleine und mittlere Losgrößen oder hohe Stückzahlen, als High Reliability Business Unit innerhalb der Unimicron Technology Group, einer der weltweit führenden Hersteller für PCBs, hat Unimicron Germany direkten Zugriff auf die asiatischen Partnerwerke.

Abbildungen und Bildunterschriften:

Abb 1:

Unimicron Germany investiert rund 12 Mio. Euro in den Neubau eines Produktgebäudes und in modernste Fertigungstechnologie



Abb 2:

Höchste Flexibilität und beste Ergebnisse mit der modernen vertikalen Plating-Anlage (VCP) zur Kupferbeschichtung von Leiterplatten



August 2022

Seite 4 von 4

Pressekontakt:

Beate Weigandt

Email: beate.weigandt@unimicron.de

Oliver Holz

Email: oliver.holz@unimicron.de

Telefon: 0 28 31 - 3 94 - 0

Abb 3:

Die neue horizontale Durchkontaktierungslinie ermöglicht eine vergrößerte Flexibilität hinsichtlich Leiterplattentechnologien, sowie eine signifikante Einsparung von Wasser und Energie

